



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
EIDGENÖSSISCHES INSTITUT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

(11) **CH 697 112 B8**

(19)

Erfindungspatent für die Schweiz und Liechtenstein

Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

(51) Int. Cl.: **H01F 27/245** (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01)
H01F 3/02 (2006.01)
H01F 27/24 (2006.01)
C22C 45/00 (2006.01)

(12) **PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1
INID code(s) 72

(21) Anmeldenummer: 00895/05

(22) Anmeldedatum: 27.09.2004

(30) Priorität: 26.09.2003 JP 2003 336 589

(24) Patent erteilt: 30.04.2008

(45) Patentschrift veröffentlicht: 30.04.2008

(48) Berichtigung veröffentlicht: 15.08.2008

(73) Inhaber:
Mitsui Chemicals, Inc.,
5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku
Tokyo 105-7117 (JP)

(72) Erfinder:
Mitsunobu Yoshida, Chiba 299-0265 (JP)
Nobuhiro Maruko, Chiba 299-0265 (JP)
Hiroshi Watanabe, Chiba 299-0265 (JP)

(74) Vertreter:
E. Blum & Co. AG Patent- und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11
8044 Zürich (CH)

(86) Internationale Anmeldung:
PCT/JP 2004/014084

(87) Internationale Veröffentlichung:
WO 2005/031767

(54) **Laminat magnetischer Substrate und Verfahren zur Herstellung derselben.**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Laminat magnetischer Substrate mit einer hohen thermischen Konduktivität, um einen Zerfall der Wärmefreisetzungsseigenschaften zu verhindern, der durch eine niedrige thermische Konduktivität ausgelöst wird, wenn exotherme Wärme aufgrund des Kernverlusts des Laminats magnetischer Substrate, umfassend eine dünne Magnetmetallplatte und eine hochmolekulare Verbindung, nach aussen freigesetzt wird.

Das Laminat magnetischer Substrate, umfassend eine hochmolekulare Verbindungsschicht und eine dünne Magnetmetallplatte, wird verwendet, wobei der spezifische Volumenwiderstand wie definiert in der JIS H0505 zu einer Richtung senkrecht zur hochmolekularen Verbindungsschichtoberfläche des Laminats weniger als 10^8 #cm beträgt. Das Laminat ist mit einem elektrischen Kontinuitätspunkt versehen, erzeugt zwischen den dünnen Magnetmetallplatten, so dass die hochmolekulare Verbindung innerhalb des Laminats zu der Aussenseite des Laminats durch Drucken auf das Laminat gedrückt wird.